## フェムト秒レーザ直接還元描画法における CuO ナノ粒子の還元特性評価

Reduction properties of CuO nanoparticles in femtosecond laser direct reduction patterning

○溝尻 瑞枝¹, 荒金 駿¹, 櫻井 淳平¹, 秦 誠一¹(1. 名大院工)

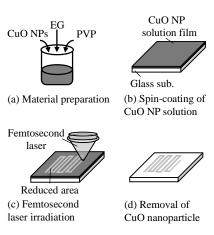
°Mizue Mizoshiri<sup>1</sup>, Shun Arakane<sup>1</sup>, Junpei Sakurai<sup>1</sup>, Seiichi Hata<sup>1</sup> (1. Nagoya Univ.)

E-mail: mizoshiri@mech.nagoya-u.ac.jp

フェムト秒レーザ直接描画法は、焦点近傍で生じる局所反応を利用した微細加工法として注目 されている. これまでに樹脂や貴金属の 2,3 次元直接描画法が報告される一方で,Cu 等の易酸 化材料の大気中での直接描画は困難であった 1-2). そこで我々は、フェムト秒レーザ直接還元描画 法を提案し、大気中で安定な金属酸化物ナノ粒子のレーザ還元を利用した金属微細パターニング について研究を進めてきた. 本発表では、CuOナノ粒子を用いた Cu微細パターニングにおいて、 その還元特性を評価した.

図1にCuのフェムト秒レーザ直接還元描画法を示す.CuOナノ粒子(平均粒径<50 nm, 60 wt%) をエチレングリコール(EG, 27 wt%), ポリビニルポロリドン(PVP, 13 wt%)と混合し, CuO ナ ノ粒子溶液を調製した. 次に, CuO ナノ粒子溶液をガラス基板上へ膜厚 8 μm にスピンコートし た. 大気中でフェムト秒レーザを集光し, 300 μm×300 μm のパターンを描画した. レーザ波長, パルス幅, 繰返し周波数はそれぞれ 780 nm, 120 fs, 80 MHz とした. 最後に非描画領域の CuO ナ ノ粒子を EG で除去した.

図 2 に異なる条件でレーザ描画したパターンの XRD スペクトルを示す. レーザ描画速度 100 um/s, パルスエネルギー0.96 nJ のとき顕著な Cu 回折ピークが観察された. 更に, CuO ナノ粒子 の Cu 還元量は、総照射エネルギー量に伴い増加するのではなく、レーザ描画速度の増大とともに 増加した.この結果は、大気中のCu 還元においてレーザ描画速度の増大に伴いCu の再酸化を抑 制でき、高効率に Cu 還元描画が行えることを示唆している.



Intensity (arb. units) Scan speed: 50 μm/s Pulse energy: 1.2 nJ Scan speed: 50 µm/s Pulse energy: 0.96 nJ Scan speed: 100 µm/s Pulse energy: 0.96 nJ Scan speed: 50 µm/s Pulse energy: 0.60 nJ Scan speed: 50 μm/s Pulse energy: 0.38 nJ 30 40 50 60 **70** 2 theta (degree)

Cu∇uOCuO

Scan speed: 20 µm/s Pulse energy: 1.2 nJ

図1フェムト秒レーザ還元描画法 による Cu 微細パターニング.

図2 レーザ描画パターンの XRD スペクトル.

1) S. Kawata, et al., Nature, 412 (2001) 697. 2) S. Maruo, et al., Opt. Express, 16 (2008) 1174.